

2024年1月23日

各位



【出展のお知らせ】ネプコンジャパン 2024 半導体・センサパッケージング展

当社は「ネプコンジャパン 2024 半導体・センサパッケージング展」に出展いたします。
この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



会 期：2024年1月24日(水)～1月26日(金) 開場時間：10:00～17:00
会 場：東京ビッグサイト 東展示棟 当社ブース:小間番号 E30-40

【展示内容】

1. 非破壊で金線ワイヤーボンドの接合や熱抵抗不良を検出
～『Laser Bond Tester II+Magazine Changer』実機展示～
2. 複雑な重なりあったクロスワイヤーの検査が可能
～ 次世代ワイヤーボンド検査装置『Multi-Z』実機展示～
3. フリップチップの接続不具合を X 線画像と AI で検出
～『E box+AIbox システム』デモ実演～
4. ダイシングチップをランク別に分類と6面外観検査し、ウェハーリングに移載
～ W2W 外観検査移載装置『iNverter』～(動画展示)
5. IR を利用しテープ越しにダイシングウェハー内部のクラック検査を自動検出！
～ウェハーAOI外観検査装置『i Focus』～(動画展示)
6. 工場での狭い通路やグレーチングやエレベーターでの自動搬送を実現する球駆動式 AMR
～世界初の球駆動式 AMR の実機展示～

総称 **ネプコン ジャパン 2024** 展示会へのご招待

第25回 **半導体・センサ パッケージング展**
半導体後工程の専門展 **ISP**

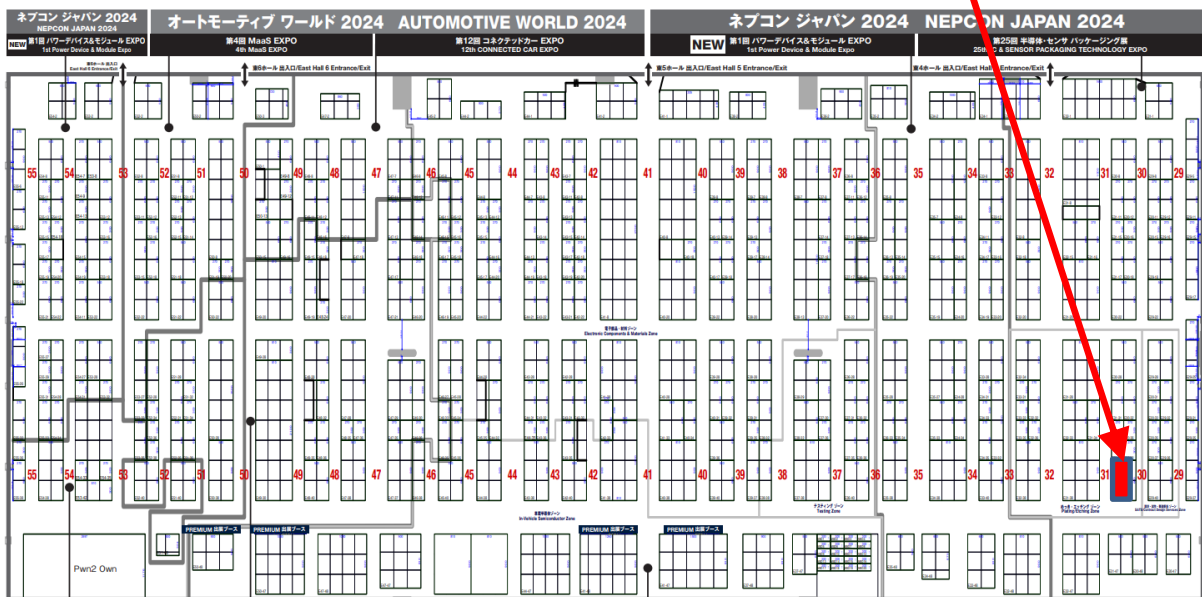
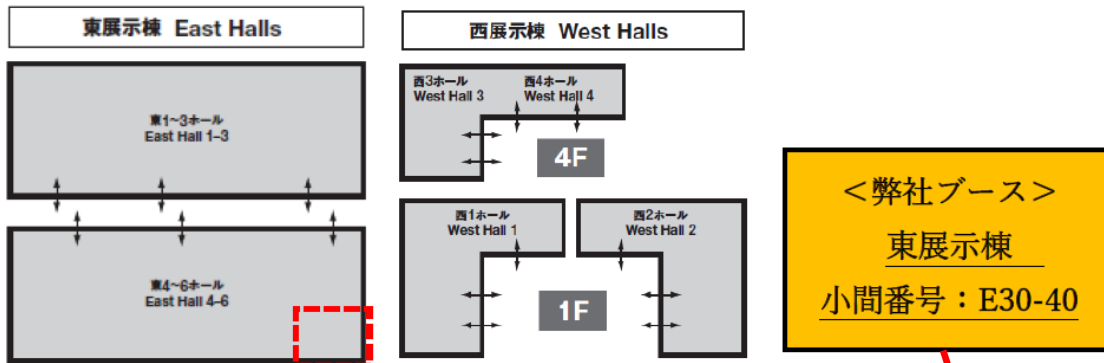
会期 2024年1月24日(水)~26日(金) 10:00-17:00 会場 東京ビッグサイト 主催 RX Japan株式会社

! 来場方法が変わりました ▶▶▶ 事前の来場登録が必要です (無料)

- 1 下記URL より来場登録
- 2 登録後に発行される来場者バジンをカラー印刷
- 3 来場者バジン提示でそのまま展示会場に入場



【来場登録 URL】 <https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja.jp/visit.html>



以上